

概要

LSI(Large Scale IC)大規模集積回路はシリコン(Si)結晶板上に1,000個以上の素子(トランジスタ、ダイオード、抵抗など)を組み込んだデバイスです。(VLSI:10万個以上の素子で構成されています)

主な薄膜材料

メタル膜

スパッタリング(Al合金、Mo、W、シリサイド等)

真空蒸着(Al、Ti、Pd、Pt、Au等)

CVD(Mo、W、Cu等)

絶縁膜

スパッタリング(SiO₂、Si₃N₄等)

CVD(SiO₂、PSG等)

プラズマCVD(SiO₂、Si₃N₄等)

関連商品

・LSI

デジタルIC-バイポーラ型

- DTL、TTL、ECL、I²L

- MOS型 - pMOS、nMOS、cMOS

アナログIC - OPアンプ

・ICメモリー(記憶素子)

- RAM - DRAM、SRAM

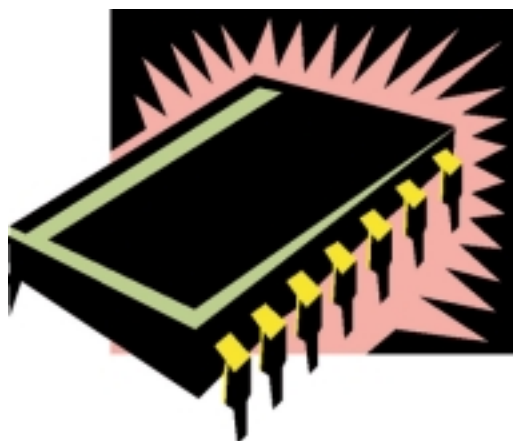
- RAM - アスターRAM

- PROM、EPROM、EEPROM

- SAM - シフトレジスター

用途

コンピュータ、
家庭用電気製品 等



原理図

DRAMの構造

